



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080818002
2008年8月27日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎

TI-Tucson製造一部製品 組立/検査サイト変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	<input checked="" type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Test	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	TI-Tucson 製造一部製品 組立/検査サイト変更 現行：TI-Tucson (USA) 変更後：MMT 社 (ALP 社:Thailand) 注)ALP (AlpaTec) 社は MMT (Millenium Microtech) 社になっています。			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12 月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルにつきましては 10 月上旬を予定しています。)			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	－			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-Tucson製造一部製品 組立/検査サイトについて、TI-Tucson製造終了に伴い、TI-Tucsonサイトに替わり MMT社(Millennium Microtech社:旧ALP社(タイ))での製造に移行し認定する予定です。また、出荷梱包部材(梱包箱、テープ&リール、トレイなど)につきましては、認定しましたサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立/検査サイト	TI-Tucson	MMT社(旧ALP社)

理由: 製品供給能力維持確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
ADS7800AH	ISO102B	ISO121G	OPA2541BM	OPA541BM
ADS7800BH	ISO106	LOG100JP-2	OPA2541SM	OPA541SM
DAC811AH	ISO106B	MPY100AG	OPA2541SMQ	OPA637SM
DAC811BH	ISO120BG	MPY100BG	OPA404AG	XTR101AG
INA101AG	ISO120G	MPY100CG	OPA404BG	XTR101BG
INA110SG	ISO120SG	MPY100SG	OPA404SG	XTR110AG
ISO102	ISO121BG	OPA2541AM	OPA541AM	XTR110BG

製品表示

今回の変更の伴い出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び原産国(ラベル箇所:23L)が各々下記の様になる予定です。

	現行	変更後
組立サイト	TI-Tucson	MMT社
原産地(22L)	BRB	ALP
原産国(23L)	USA	THA



図1 出荷ラベルの表示箇所の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2008年3月	終了	2008年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
DEVICE-ID	A	B	C	
Qual Device:	ADS7800BH	INA110SG	XTR110BG	
Die Size (mils)	C / 136 X 184	T / 89 X 139	78 x 109	
Wafer fab Site	TUA	TUA	SFAB/HFAB	
Technology	Bipolar	Bipolar	Bipolar	
Fab Process	490N	-	630G	
Resistor technology	-	-	SiCr	
Assembly Site	MMT	MMT	MMT	
Package /ode/ Pin	CDIP / JDN / 24	CDIP / JD / 16	CDIP / JD / 16	
Lead Finish	Gold	Gold	Gold	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		A	B	C
**Steady-state Life Test	150C, 168hrs (500*, 1000* Hrs)	116	116	116
**Temp Cycle	-65C/150C, 1000 Cyc)	77	77	77
Resistance to Solvents	Ink symbol only	22	22	22
Electrical Test	D4 Done post visual insp.	32	32	32
Bond Strength	76 bonds, min. 3 units	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Per Qual lot		
D4 Mechanical Shock	Condition B	32	32	32
D4 Vibration	Condition A	32	32	32
D4 Constant Acceleration	Condition E	32	32	32
Fine and Gross leak	D4 Sequence	32	32	32
Visual Inspection	-	32	32	32
Destructive Physical Analysis	Unstressed	5	5	5
* for Information only				
**- Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2008年5月	終了	2008年6月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ISO120G	Assembly Site	MMT	
Package /ode/ Pin	CDIP / JVA / 16	Lead Finish	Gold	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		A	B	C
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs	116		
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cyc	77		
Resistance to Solvents	Ink symbol only	22		
Electrical Test	D4 Done post visual insp.	32		
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76		
Die Shear	-	10		
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Per Qual lot		
D4 Mechanical Shock	Condition B	32		
D4 Vibration	Condition A	32		
D4 Constant Acceleration	Condition E	32		
Fine and Gross leak	-	32		
Internal Water Vapor	5000 PPM Max	5		
Visual Inspection	D4 Sequence	32		
Destructive Physical Analysis	Unstressed	5		
**- Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2008年8月	終了	2008年11月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	INA117BM	Die Rev/Size(MILS)	A / 85 x 103	
Wafer fab Site	HFAB/TFAB	Technology	Bipolar	
Fab Process	HU-BIP-4 (630G)	Metal 1	AlCu (0.5%)	
Resistor technology	SiCr	Passivation	5kASiO2/8kASiON	
Die Overcoat	PI-2562			
Assembly Site	ALP (MMT)	Package Designator	LMC TO99	
Mount compound	ABLEB 84-1 LMISR4	Wire Bond	TS - Au	
Lead Frame Finish	Au			
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs		116	
Resistance to Solvents	Ink symbol only		22	
Destructive Physical Analysis	Unstressed - inspect laser trims and die coat application		5	
Manufacturability	Per mfg. Site specification		Per Qual lot	
Fine and Gross leak	-		39	
** Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2008年4月	終了	2008年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2541BM	Technology	Bipolar	
Fab Process	634G			
Assembly Site	ALP (MMT)	Package Code/ Pin	LMF / 8	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs		116	
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cyc		77	
Resistance to Solvents	Ink symbol only		22	
PIND	use 009-129 test conditions - For information		10	
Bond Strength	20 bonds per wire size, min. 3 units		20	
Die Shear	-		10	
Destructive Physical Analysis	Unstressed		5	
Manufacturability	Per mfg. Site specification		Per Qual lot	
D4 Mechanical Shock	Condition B		32	
D4 Vibration	Condition A		32	
D4 Constant Acceleration	Condition E		32	
Fine and Gross leak	-		32	
X-ray	Inspect for attach voiding		5	
Visual Inspection	D4 Sequence-		32	
D4 Electrical Test	post D4 Sequence		32	
** Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence				